

江苏捷捷微电子股份有限公司

关于深圳证券交易所年报问询函的回复公告

江苏捷捷微电子股份有限公司于2020年5月11日下午收到深圳证券交易所创业板公司管理部《关于对江苏捷捷微电子股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函【2020】第188号），公司已于2020年5月18日向深圳证券交易所提交对问询函的回复，现按照相关要求公告如下：

1.报告期内，你公司购买商品、接受劳务支付的现金 6,841.32 万元，较 2018 年同比下滑 68.43%，当期营业成本为 36,989.71 万元。请你公司说明报告期内现金流量表编制口径较 2018 年度是否发生变化，如是，请说明原因及合规性。请年审会计师发表意见。

公司回复：

一、公司的分析及说明

2019 年度现金流量表编制口径较 2018 年度发生了变化，2019 年度公司未将销售商品收到的商业票据通过背书转让给供应商结算货款的金额计入现金流量表。

2018 年度、2019 年度间接法下购买商品、接受劳务支付的现金的勾稽关系如下：

单位：万元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|---------------------|-----------|-----------|
| 加：营业成本 | 36,989.71 | 27,484.55 |
| 加：原材料采购的进项税金 | 3,788.81 | 3,443.05 |
| 加：存货期末余额减期初余额 | 1,972.82 | 2,484.37 |
| 加：研发费用中耗用存货的金额 | 761.56 | 278.25 |
| 加：预付账款期末余额减期初余额 | 128.47 | 21.90 |
| 减：经营活动应付账款期末余额减期初余额 | 2,266.13 | 1,318.50 |

| | | |
|--------------------------|-----------------|------------------|
| 减：计入营业成本的职工薪酬 | 5,184.08 | 5,381.12 |
| 减：计入营业成本的折旧费用 | 5,624.91 | 5,343.44 |
| 减：收到的银行承兑汇票背书用于支付供应商货款金额 | 22,891.72 | - |
| 减：收到的商业承兑汇票背书用于支付供应商货款金额 | 833.20 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,841.32 | 21,669.05 |

2019 年度现金流量表编制口径较 2018 年度发生了变化，一方面严格按照准则来处理，同时，考虑到银行承兑汇票背书结算涉及的金额较大，为了充分披露，公司在财务报表附注五、41 现金流量表补充资料中补充披露了票据背书的相关信息，即“2019 年公司销售商品收到的银行承兑汇票背书转让的金额为 22,891.72 万元”。

二、年审会计师履行的主要核查程序及核查意见

（一）主要核查程序

- 1、向公司管理层了解编制现金流量表的相关内部控制、编制方法；
- 2、向公司索取了 2018 年度、2019 年度现金流量表的编制底稿，对现金流量表与利润表、资产负债表相关项目的勾稽关系进行了重新计算；
- 3、结合资产负债表、利润表有关项目较前期变动情况，分析现金流量表相关项目变动的合理性；
- 4、了解 2019 年现金流量表中销售商品、提供劳务收到的现金项目及购买商品、接受劳务支付的现金项目的编制口径较 2018 年变动的的原因，确认 2019 年现金流量表列报的合规性、财务报表附注披露的充分性。

（二）核查意见

经核查，我们认为：捷捷微电 2019 年销售商品收到的商业票据背书给供应商用于结算货款的金额不在现金流量表列报，而在财务报表附注披露相关信息是正确的，公允反映了公司经营活动现金流量信息。

2.年报显示，你公司第二季度营业收入及经营活动产生的现金流量净额较第一季度均出现较大幅度增长，其中营业收入同比增长 31.95%，经营性活动现金

流金额同比增长 124.32%。请你公司说明第二季度营业收入及经营性活动现金流量净额均出现大幅增长的原因及合理性。

公司回复：

一、公司的分析及说明

（一）第二季度营业收入大幅增加的原因

公司 2019 年度第二季度营业收入较第一季度增加 3,944.88 万元，增幅 31.95%，其中：功率半导体芯片销售额增加 699.96 万元、功率半导体器件销售额增加 3,060.96 万元、其他业务收入增加 183.96 万元，第二季度营业收入增加主要是功率半导体器件的销售额增加所致。

2019 年第一季度、第二季度收入及变动情况如下：

单位：万元

| 项目 | 第一季度 | 第二季度 | 增长额 | 增幅 |
|---------|------------------|------------------|-----------------|---------------|
| 功率半导体芯片 | 2,501.90 | 3,201.86 | 699.96 | 27.98% |
| 功率半导体器件 | 9,501.19 | 12,562.15 | 3,060.96 | 32.22% |
| 其他业务收入 | 344.75 | 528.71 | 183.96 | 53.36% |
| 合计 | 12,347.84 | 16,292.72 | 3,944.88 | 31.95% |

功率半导体器件销售额增加主要是晶闸管器件、防护器件、MOS 器件这三种产品销售额增加所致，其中：晶闸管器件销售额增长 1,822.89 万元、防护器件销售额增长 827.42 万元、MOS 器件销售额增长 410.65 万元，合计增长 3,060.96 万元，占第二季度营业收入增加额的 77.59%。

上述产品销售额增长的具体原因分析如下：

（1）晶闸管器件作为公司的 IDM 传统业务，2019 年第二季度销售较第一季度销售增加主要是第一季度受春节假期的影响销量及产能利用等因素所致；

（2）防护器件 2019 年第二季度销量增长，一方面由于较第一季度春节假期的环比影响；另一方面，由于公司 IPO 募投项目“半导体防护器件生产线建设项目”2018 年初正式投产，随着市场开发力度的增强和产能利用率上升销售规模随之增长；

(3) 公司 MOS 系列产品处于快速成长期。

2019 年第一季度、第二季度功率半导体器件销售收入及变动情况如下：

单位：万元

| 项目 | 第一季度 | 第二季度 | 增长额 | 增幅 |
|--------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|
| 晶闸管器件 | 6,274.25 | 8,097.14 | 1,822.89 | 29.05% |
| 防护器件 | 2,840.11 | 3,667.53 | 827.42 | 29.13% |
| MOS 器件 | 386.83 | 797.48 | 410.65 | 106.16% |
| 合计 | 9,501.19 | 12,562.15 | 3,060.96 | 32.22% |

(二) 第二季度经营性活动现金流净额大幅增加的原因

2019 年第二季度经营活动现金流量金额较第一季度增加约 3,647.15 万元，主要是经营活动现金流入增加 1,927.83 万元、经营活动现金流出减少 1,719.33 万元，具体分析如下：

1、经营活动现金流入增加

2019 年度第二季度经营活动现金流入较第一季度增加 1,927.83 万元，其中：
 (1) 销售商品、提供劳务收到的现金增加 732.29 万元，主要是应收账款回款增加所致；
 (2) 收到的税费返还增加 345.24 万元，主要是第二季度收到的出口退税较第一季度增加所致；
 (3) 收到其他与经营活动有关的现金增加 850.30 万元，主要是第二季度收到政府补助 629.77 万元所致。

2、经营活动现金流出减少

2019 年度第二季度经营活动现金流出较第一季度减少 1,719.33 万元，其中：
 (1) 支付给职工以及为职工支付的现金减少 927.94 万元，主要是 2019 年 1 月发放 2018 年度年终奖 1,137.87 万元所致；
 (2) 支付的各项税费减少 920.42 万元，主要是一季度预缴 2018 年企业所得税 350.00 万元，第二季度退回 350.00 万元所致。

3、经营活动现金流具体情况

2019 年第一季度、第二季度公司经营活动现金流量金额及变动情况如下：

单位：万元

| 项目 | 第一季度 | 第二季度 | 变动金额 | 变动比例 |
|----------------|-----------|-----------|----------|----------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,405.21 | 15,137.50 | 732.29 | 5.08% |
| 收到的税费返还 | 30.51 | 375.75 | 345.24 | 1131.56% |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 405.81 | 1,256.11 | 850.30 | 209.53% |
| 经营活动现金流入小计 | 14,841.53 | 16,769.35 | 1,927.82 | 12.99% |

| | | | | |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,728.33 | 6,860.11 | 131.78 | 1.96% |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,866.75 | 1,938.81 | -927.94 | -32.37% |
| 支付的各项税费 | 1,698.30 | 777.88 | -920.42 | -54.20% |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 614.36 | 611.60 | -2.76 | -0.45% |
| 经营活动现金流出小计 | 11,907.74 | 10,188.41 | -1,719.33 | -14.44% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,933.79 | 6,580.94 | 3,647.15 | 124.32% |

综上，公司第二季度营业收入及经营性活动现金流净额均出现大幅增长与公司实际经营情况相符，增长变动属于合理范围内的变动。

3.报告期末，你公司应收款项融资科目余额 5,259.83 万元，均为应收票据。请补充说明利用应收款项融资的原因、具体方式、票据性质及金额，是否与以前年度存在较大差异，如是，请说明原因。

公司回复：

一、公司的分析及说明

公司目前主要通过和供应商约定以票据背书的结算方式替代银行转账的结算方式进行应收款项融资。2019 年末应收款项融资科目余额 5,259.83 万元，均为应收银行承兑汇票。

按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量（2017 年 3 月修订）》及相关规定，该类票据应分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产并在“应收款项融资”科目列报。具体说明如下：

1、新金融工具准则规定

《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量（2017 年 3 月修订）》第十八条 金融资产同时符合下列条件的，应当分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：（一）企业管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。（二）该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

2、报表格式通知要求

财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）规定，“应收票据”项目，反映资产负债表日以摊余成本计量的、

企业因销售商品、提供服务等收到的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票；资产负债表新增“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。

3、新金融工具准则应用指南规定

《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》应用指南（2018）：“企业确定其管理金融资产的业务模式时，应当注意以下方面：（1）企业应当在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，而不必按照单个金融资产逐项确定业务模式。金融资产组合的层次应当反映企业管理该金融资产的层次。……（3）企业应当以企业关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。（4）企业的业务模式并非企业自愿指定，而是一种客观事实，通常可以从企业为实现其目标而开展的特定活动中得以反映。

公司银行承兑汇票的业务模式是以出售该金融资产为首要目标，同时兼具以收取合同现金流量为次要目标。2018 年度、2019 年度公司收到的银行承兑汇票用于背书的合计金额比例为 67.99%，到期承兑的合计金额比例为 32.01%，具体情况如下：

单位：万元

| 项目 | 背书 | 承兑 | 合计 |
|---------|------------------|------------------|------------------|
| 2019 年度 | 22,891.72 | 7,979.58 | 30,871.30 |
| 比例 | 74.15% | 25.85% | 100.00% |
| 2018 年度 | 20,106.64 | 12,259.79 | 32,366.43 |
| 比例 | 62.12% | 37.88% | 100.00% |
| 合计 | 42,998.36 | 20,239.37 | 63,237.73 |
| 比例 | 67.99% | 32.01% | 100.00% |

公司 2019 年度利用银行承兑汇票进行应收款项融资的原因、具体方式、票据性质及金额与以前年度不存在较大差异。

4.年报显示，报告期内按组合计提坏账准备的应收账款账面余额 20,901.97 万元，在组合基础上计算预期信用损失，坏账计提比例为 5.42%，2018 年同期坏账准备计提比例为 7.57%，各个账龄区间应收账款坏账计提比例较 2018 年均发生较大变化，2019 年度新增计提坏账准备 0.41 万元。

(1) 请提供应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，说明各账龄区间应收账款预期信用损失的确认过程及依据。请会计师核查并发表意见。

(2) 请提供截至收到本问询函之日应收账款的期后回款情况，并对应收账款坏账准备计提的充分性进行补充说明。请会计师核查并发表意见。

公司回复：

一、公司的分析说明

1、应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表

2017年3月31日财政部修订发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（以下简称“新金融工具准则”），要求对金融资产减值准备的计提方法由“已发生的减值损失法”调整为“预期信用损失法”，公司采用以账龄表为基础的迁徙减值矩阵计量2019年12月31日应收账款的预期信用损失。

公司计算以账龄表为基础的迁徙减值矩阵时，按照国内客户与国外客户划分成两不同风险特征组合，分别计量各组合的预期信用损失，2019年12月31日，公司应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表。

| 国内客户 | |
|-----------|--------|
| 账龄 | 预计损失率 |
| 1-30 天 | 3.34% |
| 31-60 天 | 3.36% |
| 61-90 天 | 4.32% |
| 91-120 天 | 5.43% |
| 121-365 天 | 14.82% |
| 1-2 年 | 81.42% |
| 2-3 年 | 97.90% |
| 3 年以上 | 99.45% |
| 国外客户 | |
| 账龄 | 预计损失率 |
| 1-30 天 | 0.14% |
| 31-60 天 | 0.14% |
| 61-90 天 | 0.14% |
| 91-120 天 | 0.14% |
| 121 天以上 | 3.71% |

2、各账龄区间应收账款预期信用损失的确认过程及依据

公司计算以账龄表为基础的迁徙减值矩阵，按照国内客户与国外客户划分成两个不同风险特征组合，分别计量预期信用损失，确认过程及依据如下：

(1) 选取国内客户与国外客户 2018 年应收账款年末余额，并追踪这些应收账款在 2019 年的回收情况，计算 2019 年实际回收率。

(2) 考虑前瞻性信息，公司以中国银行保险监督管理委员会公布的同期商业银行贷款拨备率的增长率作为公司当期前瞻性调整系数。商业银行贷款拨备率是全国商业银行对全国贷款客户的信用减值计提比例，该比例年度间的波动一定程度上能够反映当期宏观经济环境的变动对企业信用的影响，故公司采用该变动率作为调整基数。

| 年度 | 贷款拨备率 | 备注 |
|---------------|---------|----|
| 2018 年末 | 3.3650% | |
| 2019 年 3 季末 | 3.4900% | 说明 |
| 贷款拨备率增长率 | 3.71% | |
| 2019 年前瞻性调整系数 | 3.71% | |

说明：公司在确认 2019 年度预期信用损失时中国银行保险监督管理委员会尚未公布 2019 年末的商业银行贷款拨备率，故公司取 2019 年 3 季度末数据进行计算。

(3) 根据 2018 年应收账款实际回收率以及前瞻性调整系数，计算 2019 年末各账龄段应收账款的预计回收率。

| 国内客户 | | | |
|-----------|---------------------|---------|---------------------|
| 账龄 | 2018 年应收账款 实际回收率 | 前瞻性调整系数 | 2019 年应收账款 预计回收率 |
| 1-30 天 | 99.60% | 3.71% | 95.90% |
| 31-60 天 | 99.57% | 3.71% | 95.87% |
| 61-90 天 | 98.34% | 3.71% | 94.69% |
| 91-120 天 | 96.93% | 3.71% | 93.33% |
| 121-365 天 | 84.95% | 3.71% | 81.80% |
| 1-2 年 | 17.48% | 3.71% | 16.83% |
| 2-3 年 | 1.62% | 3.71% | 1.56% |
| 3 年以上 | 0.57% | 3.71% | 0.55% |
| 国外客户 | | | |
| 账龄 | 2018 年应收账款 实际回收率 | 前瞻性调整系数 | 2019 年应收账款 预计回收率 |
| 1-30 天 | 100.00% | 3.71% | 96.29% |

| | | | |
|----------|---------|-------|--------|
| 31-60 天 | 100.00% | 3.71% | 96.29% |
| 61-90 天 | 100.00% | 3.71% | 96.29% |
| 91-120 天 | 100.00% | 3.71% | 96.29% |
| 121 天以上 | 100.00% | 3.71% | 96.29% |

说明：2019 年应收账款预计回收率=2018 年应收账款实际回收率*(1-前瞻性调整系数)。

(4) 根据 2019 年度应收款年预计回收率计算 2019 年迁徙率，最后计算得出 2019 年预期信用损失率。

| 国内客户 | | | | |
|-----------|-----------------|------------|-----------|---------------|
| 账龄 | 2019 年应收款年预计回收率 | 2019 年末迁徙至 | 2019 年迁徙率 | 2019 年预计损失率 |
| 1-30 天 | 95.90% | 1-2 年 | 4.10%[H] | 3.34%[P=H*K] |
| 31-60 天 | 95.87% | 1-2 年 | 4.13%[G] | 3.36%[O=G*K] |
| 61-90 天 | 94.69% | 1-2 年 | 5.31%[F] | 4.32%[N=F*K] |
| 91-120 天 | 93.33% | 1-2 年 | 6.67%[E] | 5.43%[M=E*K] |
| 121-365 天 | 81.80% | 1-2 年 | 18.20%[D] | 14.82%[L=D*K] |
| 1-2 年 | 16.83% | 2-3 年 | 83.17%[C] | 81.42%[K=C*J] |
| 2-3 年 | 1.56% | 3 年以上 | 98.44%[B] | 97.90%[J=B*I] |
| 3 年以上 | 0.55% | 3 年以上 | 99.45%[A] | 99.45%[I=A] |
| 国外客户 | | | | |
| 账龄 | 2019 年预计回收率 | 2019 年末迁徙至 | 2019 年迁徙率 | 2019 年预计损失率 |
| 1-30 天 | 96.29% | 121 天以上 | 3.71%[E] | 0.14%[J=E*F] |
| 31-60 天 | 96.29% | 121 天以上 | 3.71%[D] | 0.14%[I=D*F] |
| 61-90 天 | 96.29% | 121 天以上 | 3.71%[C] | 0.14%[H=C*F] |
| 91-120 天 | 96.29% | 121 天以上 | 3.71%[B] | 0.14%[G=B*F] |
| 121 天以上 | 96.29% | 121 天以上 | 3.71%[A] | 3.71%[F=A] |

说明：2019 年迁徙率=1-2019 年预计回收率

3、截至收到本问询函之日（2020 年 5 月 11 日）应收账款的期后回款情况如下：

| 项目 | 金额（万元） |
|-------------------------------|-----------|
| 2019 年末应收账款余额（A） | 21,315.85 |
| 剔除单项计提 2019 年余额（B） | 20,901.97 |
| 截止 2020 年 5 月 11 日回款金额（C） | 19,331.59 |
| 截止 2020 年 5 月 11 日回款比例（D=C/B） | 92.49% |

| | |
|---------------------------------|-------|
| 截止 2020 年 5 月 11 日未回款比例 (E=1-D) | 7.51% |
| 2019 年末按组合计提应收账款减值准备比例 (F) | 5.42% |

4、对应收账款坏账准备计提的充分性进行补充说明

剔除单项计提的客户后，截止 2020 年 5 月 11 日，客户回款共计 19,331.59 万元，回收率为 92.49%，未回款比例为 7.51%，公司预计剩余未回款金额能够按期收回，截止本问询函回复日（2020 年 5 月 18 日），应收账款回款金额为 19,764.64 万元，回款率为 94.56%，2019 年应收账款坏账准备的计提比例与实际回收情况不存明显差异，公司对 2019 年末计提的应收账款坏账计提充分。

二、年审会计师执行的主要核查程序及意见

（一）主要核查程序

1、向公司管理层了解对客户的信用政策、客户在以前年度的回款情况、以前年度审计报告中公司的坏账政策及坏账计提情况；

2、获取公司编制的 2019 年度应收账款预期信用损失模型及底稿，对模型中涉及的数据来源及依据进行分析性复核，确认取数的合理性及适用性，并对预期信用损失率的确认过程进行重新计算；

3、对 2019 年度各个账龄区间应收账款坏账准备计提比例较 2018 年度发生变化的原因进行了解与分析，确认 2019 年度各个账龄区间应收账款坏账准备计提比例的适当性。

4、获取截至 2020 年 5 月 11 日公司应收账款的回款明细，根据回款明细确认公司 2019 年末应收账款的金额及回款比例，并计算截止至 2020 年 5 月 11 日的应收账款未回款比例；

5、将上述未回款比例与按组合计提坏账的应收账款的坏账比例比较，了解并分析两者的差异原因，确认 2019 年按组合计提坏账的应收账款坏账准备是否计提充分。

（二）核查意见

经核查，我们认为：捷捷微电 2019 年度应收账款预期信用损失的计算过程

及依据符合新金融工具准则，2019 年末应收账款坏账准备计提充分。

5.报告期末，你公司存货中库存商品账面余额 2,615.74 万元，较期初增长 72.89%，发出商品账面余额 1,670.14 万元，较期初增长 71.30%。主要商品半导体器件期末库存量较期初增长 5.56%，半导体芯片库存量增长 18.91%。报告期内未对存货计提减值准备。

(1) 请你公司说明报告期主要商品库存量变动与库存商品账面余额变动不匹配的原因及合理性；

(2) 请你公司说明存货中库存商品的种类，并按照类别列示其账面价值、市场/合同价格、库龄，说明库存商品是否有对应的销售订单，并结合公司毛利率、存货周转情况说明存货跌价准备的计提是否充分。请会计师核查并发表意见。

(3) 请结合发出商品具体构成、验收期是否发生显著变化等详细说明期末发出商品金额增长较多的原因及合理性。

公司回复：

一、公司的分析及说明

(一) 请你公司说明报告期主要商品库存量变动与库存商品账面余额变动不匹配的原因及合理性

2019 年期末库存商品金额较期初增长 72.89%，主要库存商品结存数量期末较期初增长 5.25%，主要商品库存量变动与库存商品账面余额变动不匹配主要原因是 MOS 功率半导体芯片结存占比增加，2019 年期初、期末该产品占库存商品比例分别为的 9.82%、37.65%，该产品的平均单位成本约 1110 元/片远高于其他产品的单位成本，随着 MOS 功率半导体芯片期末结存数量增加，库存商品期末结存金额增长幅度大于库存商品期末结存数量的增长幅度。

公司报告期内主要商品库存量、库存商品账面余额、单价统计如下：

| 产品类别 | 期末结存数量 (万片/万支) | 期末结存金额(万 元) | 期末结存单价(元/ 片、只) |
|------|-------------------|----------------|-------------------|
|------|-------------------|----------------|-------------------|

| | | 2019年 | 2018年 | 2019年 | 2018年 | 2019年 | 2018年 |
|----------------|----------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| 功率半导体芯片 | | | | | | | |
| 晶闸管芯片 | | 0.51 | 1.36 | 34.80 | 74.92 | 68.24 | 55.09 |
| 防护器件芯片 | 自产芯片 | 0.79 | 0.29 | 62.03 | 28.75 | 78.52 | 99.14 |
| | ESD等外购芯片 | 0.20 | 0.21 | 103.29 | 98.02 | 516.45 | 466.76 |
| MOS芯片 | | 0.89 | 0.15 | 984.82 | 148.54 | 1,106.54 | 990.27 |
| 芯片小计 | | 2.39 | 2.01 | 1,184.94 | 350.23 | 495.79 | 174.24 |
| 芯片变动 | | 18.91% | | 238.33% | | 184.54% | |
| 功率半导体器件 | | | | | | | |
| 晶闸管器件 | | 3,658.32 | 3,176.04 | 460.85 | 344.92 | 0.13 | 0.11 |
| 防护器件 | | 8,674.09 | 8,900.17 | 816.16 | 753.07 | 0.09 | 0.08 |
| MOS器件 | | 967.59 | 560.64 | 153.79 | 64.76 | 0.16 | 0.12 |
| 器件小计 | | 13,300.00 | 12,636.85 | 1,430.80 | 1,162.75 | 0.11 | 0.09 |
| 器件变动 | | 5.25% | | 23.05% | | 22.22% | |
| 合计 | | 13,302.39 | 12,638.86 | 2,615.74 | 1,512.98 | 0.20 | 0.12 |
| 合计变动 | | 5.25% | | 72.89% | | 66.67% | |

公司功率半导体器件4寸兼容6寸芯片生产线,主要服务于4寸晶圆(IDM)。目前6寸、8寸晶圆主要是委外流片或部分外购(即芯片设计与器件封测主要由公司完成),由于芯片类型、规格及生产模式等原因,公司外购或委托加工的MOS芯片与公司自产的晶闸管芯片、防护芯片单位成本价差异极大,相关产品单位成本列示如下:

| 生产形式 | 芯片类别 | 主要型号/规格 | 成本价元/片 |
|------|-------|---------|-----------------|
| 自产 | 晶闸管芯片 | 4英寸晶圆片 | 60.00-110.00 |
| 自产 | 防护芯片 | 4英寸晶圆片 | 70.00-120.00 |
| 委托加工 | MOS芯片 | 6英寸晶圆片 | 500.00-800.00 |
| 外购 | MOS芯片 | 8英寸晶圆片 | 1700.00-3500.00 |

综上,2019年末较期初主要库存商品库存量变动与库存商品账面余额变动不匹配主要是MOS产品单位成本较高,同时MOS产品余额占比增加所致。

(二)请你公司说明存货中库存商品的种类,并按照类别列示其账面价值、市场/合同价格、库龄,说明库存商品是否有对应的销售订单,并结合公司毛利率、存货周转情况说明存货跌价准备的计提是否充分。

1、库存商品的种类、账面价值、市场/合同价格、库龄情况

公司产品主要分类为功率半导体芯片及功率半导体器件，两类又可细分为晶闸管产品、防护类产品及 MOS 产品。

2019 末库存商品的种类、账面价值、市场/合同价格、库龄情况列示如下：

| 产品 大类 | 主要商品类别 | 账面余额 (万元) | 库龄 (万元) | | 平均市场价 (含税) (元/片、只) | |
|---------------------|------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------------|--------|
| | | | 1 年以内 | 1 年以上 | | |
| 功率 半导 体芯 片 | 晶闸管芯片 | 34.80 | 31.25 | 3.55 | 218.97 | |
| | 防护器件 芯片 | 自产芯片 | 62.03 | 39.85 | 22.18 | 159.46 |
| | | ESD 等外 购芯片 | 103.29 | 88.14 | 15.15 | 注 |
| | MOS 芯片 | 984.82 | 973.11 | 11.71 | 1,267.75 | |
| 功率 半导 体器 件 | 晶闸管器件 | 460.85 | 454.49 | 6.36 | 0.39 | |
| | 防护器件 | 816.16 | 762.70 | 53.46 | 0.17 | |
| | MOS 器件 | 153.79 | 152.83 | 0.96 | 0.17 | |
| 合计 | | 2,615.74 | 2,502.37 | 113.37 | — | |

注：外购芯片用于下一步封装，不直接对外销售。

公司 2019 年末库存于 2020 年一季度基本售完，2019 年期末结存及 2020 年一季度销售情况统计如下：

| 产品大 类 | 产品类别 | 期末结存数量 (万片/万只) | 2020 年一季度销量 (万片/万只) | |
|-----------------|--------|-------------------|------------------------|-------|
| 功率半 导体芯 片 | 晶闸管芯片 | 0.51 | 6.81 | |
| | 防护器件芯片 | 自产芯片 | 0.79 | 10.75 |
| | | ESD 等外购芯片 | 0.20 | 注 |
| | MOS 芯片 | 0.89 | 1.71 | |
| 功率半 导体器 件 | 晶闸管器件 | 3,658.32 | 18,512.97 | |
| | 防护器件 | 8,674.09 | 29,868.83 | |
| | MOS 器件 | 967.59 | 3,051.64 | |

注：外购芯片用于下一步封装，不直接对外销售。

2、存货跌价准备的计提情况

(1) 存货跌价准备的计提方法

公司资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货

的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（2）2019 年末存货跌价准备的计提情况

公司的产品主要为功率半导体芯片及器件，对材料及产品精度要求高，2019 年期末库龄 1 年以内的库存商品金额为 2,502.37 万元，占比 95.67%，库龄 1 年以上的金额为 113.37 万元、占比 4.33%，库存商品主要分布在 1 年以内，期末不存在呆滞或明显毁损的存货；2018 年、2019 年存货周转率分为 3.15、3.37，近两年存货周转率较为稳定。

2019 年公司主要产品毛利为 44.56%，从毛利率情况看，除 MOS 芯片产品外，其他产品的毛利率远高于 2019 年度销售费用率与税金率之和（4.97%），其他产品未见明显减值迹象。

2019 年末公司对原材料、在产品、库存商品、发出商品等按照存货跌价准

备的计提方法对存货进行了跌价测试，经测算，除 MOS 芯片产品存在减值外其他产品无减值，期末 MOS 芯片产品减值金额为 30.30 万元，由于金额较小，根据重要性原则，期末未计提相关存货跌价准备。

（三）请结合发出商品具体构成、验收期是否发生显著变化等详细说明期末发出商品金额增长较多的原因及合理性。

1、发出商品的构成

2018 年末、2019 年期末发出商品的构成情况如下：

单位：万元

| 产品大类 | 主要商品类别 | 2019 年末余额 | 2018 年末余额 | 2019 年较 2018 年增加 |
|---------|--------|-----------------|---------------|------------------|
| 功率半导体芯片 | 晶闸管芯片 | 29.54 | 46.45 | -16.91 |
| | 防护器件芯片 | 160.18 | 168.74 | -8.56 |
| | MOS 芯片 | 476.55 | 53.44 | 423.11 |
| 功率半导体器件 | 晶闸管器件 | 531.48 | 464.93 | 66.55 |
| | 防护器件 | 367.70 | 213.14 | 154.56 |
| | MOS 器件 | 104.70 | 28.29 | 76.41 |
| 合计 | | 1,670.14 | 975.00 | 695.14 |

2、发出商品增加的合理性

功率 MOSFET 广泛应用于通讯、计算机、汽车、工业控制和电子消费领域，是分立器件和智能功率集成电路的重要组成部分，也是公司定增项目主要产品之一。其一，公司 2019 年发出商品验收期与 2018 年末未发生显著变化，验收时间在 1 个月左右；其二，公司 2019 年末发出商品较 2018 年增加主要是 MOS 芯片发出金额增加所致。

二、年审会计师履行的主要核查程序及核查意见

（一）主要核查程序

1、获取期末存货的明细表，复核加计是否正确，并与总账数、明细账合计数核对是否相符；

2、获取并评价公司存货跌价准备的计提方法，检查计提存货跌价准备的依据、方法是否前后一致；

3、了解并评价计提存货跌价准备相关的内部控制；

4、获取公司存货跌价测算明细表及可变现净值所依据资料，复核并重新计算存货的跌价准备计提金额。

（二）核查意见

经核查，我们认为：公司存货跌价准备的计提方法合理，2019 年末 MOS 芯片产品存在 30.30 万元的减值，公司根据重要性原则未计提存货跌价准备，符合企业会计准则的规定。

6.报告期内，功率半导体芯片销售量同比增长 23.44%，但营业成本中材料成本较 2018 年同比增长 81.24%，制造费用较 2018 年同比增长 77.6%，请结合芯片产品产能利用率、原材料价格波动、制造费用归集口径等说明材料成本及制造费用大幅增长的原因及合理性。

公司回复：

一、公司的分析及说明

1、功率半导体芯片材料成本、制造费用增幅与销量增幅差异加大的原因

公司功率半导体芯片销售量同比增长 23.44%，但营业成本中材料成本较 2018 年同比增长 81.24%，制造费用较 2018 年同比增长 77.6%，主要是 6 寸、8 寸芯片销量增加所致。

公司功率半导体器件 4 寸兼容 6 寸芯片生产线，主要服务于 4 寸晶圆(IDM)。目前 6 寸、8 寸晶圆主要是委外流片或部分外购（即芯片设计与器件封测主要由公司完成），6 寸、8 寸芯片成本的主要是材料成本和制造费用，因此随着 2019 年度 6 寸、8 寸芯片销量增加，公司材料成本、制造费用随之大幅增加。

2、芯片产品产能及利用情况

公司目前功率半导体芯片生产线的产能为 160 万片/年，2018 年度、2019 年度自产功率半导体芯片产量分别为 150.41 万片、169.66 万片，产能利用率分别 94.01%、106.04%，产能基本饱和。

2018 年度及 2019 年度自产功率半导体芯片产能、产量情况列示如下：

单位：万片

| 项目 | 2019年 | 2018年 | 同比增减 |
|--------------|---------|--------|--------|
| 产能(A) | 160.00 | 160.00 | 0.00% |
| 生产量(B) | 169.66 | 150.41 | 11.35% |
| 产能利用率(C=B/A) | 106.04% | 94.01% | 12.03% |

3、原材料价格波动情况

2019年度原材料采购价格较2018年度变动不大，对2019年度采购前十大的原材料采购单价较2018年度变动分析如下：

| 物料名称 | 2019年度 | | 2018年度 | | 平均单价变动比例 |
|------------------|------------|-------------|------------|-------------|----------|
| | 金额 (万元) | 平均单价 (元) | 金额 (万元) | 平均单价 (元) | |
| 引线框架 TO-220AD | 762.36 | 0.1330 | 382.78 | 0.1343 | -0.97% |
| 引线框架 SOT-223 | 474.21 | 0.0189 | 505.13 | 0.0188 | 0.53% |
| 引线框架 TO-3P | 412.31 | 0.3372 | 307.13 | 0.3397 | -0.74% |
| 引线框架 TO-220FP | 375.57 | 0.1023 | 325.65 | 0.1034 | -1.06% |
| 引线框架 TO-220BD | 341.88 | 0.1098 | 55.07 | 0.1096 | 0.18% |
| 引线框架 TO-92 | 327.08 | 0.0144 | 336.75 | 0.0147 | -2.04% |
| 陶瓷片 | 300.68 | 538.6176 | 276.57 | 558.7290 | -3.60% |
| Sb衬底(100) | 255.25 | 235.9251 | 26.32 | 250.8649 | -5.96% |
| N型(111)-MCZ-研磨片 | 238.87 | 8.5200 | 113.09 | 9.0137 | -5.48% |
| N型(111)-GDFZ-研磨片 | 235.79 | 23.7078 | 86.12 | 23.9224 | -0.90% |
| 合计 | 3,724.00 | — | 2,414.60 | — | |

3、制造费用归集口径

公司主要将生产车间管理人员薪酬、设备折旧、器具摊销、水电气能耗等费用归集到制造费用，2018年度、2019年度制造费用归集口径未发生变化。

综上，报告期内，功率半导体芯片销售量同比增长23.44%，但营业成本中材料成本较2018年同比增长81.24%，制造费用较2018年同比增长77.6%，主要是6寸、8寸芯片销量增加所致。

7.报告期内，你公司研发投入3,717.71万元，同比增长42.76%。请分项目列示研发投入的具体情况、研发资金具体用途，并分析说明研发费用大幅增长的原因。

公司回复：

一、公司的分析及说明

1、研发费用大幅增长的原因

公司 2019 年度研发投入 3,717.71 万元，较 2018 年度同比增长 42.76%，主要是 2019 年研发项目数较 2018 年度研发项目数增加所致。

2019 研发立项了 39 个项目较 2018 年度的 26 个项目增加了 13 个项目，研发项目数量增长比例为 50%。2018 年度、2019 年度研发情况及资金具体用途如下：

(1) 研发项目及投入情况

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|----|-------------------------------|---------|---------|
| 1 | 宽禁带电力电子器件研发 | 276.65 | 256.62 |
| 2 | 高击穿特性高压可控硅的研发 | 186.72 | - |
| 3 | 低压平面可控硅芯片制造技术的研发 | 153.02 | - |
| 4 | 灯用 8A12A 双向可控硅的研究开发 | 150.66 | - |
| 5 | 对称性双向划片制备单台面高压可控硅的方法 | 133.06 | - |
| 6 | 半导体分立器件封装技术的研发 | 129.75 | - |
| 7 | JX012、JX014 产品工艺线路优化 | 128.03 | - |
| 8 | 两象限可控硅 LPCVD 钝化技术的研发 | 127.99 | - |
| 9 | 浅沟槽高压 GPP 芯片的研发 | 125.50 | - |
| 10 | 拼片式内绝缘组装用石墨治具的结构设计 | 125.17 | - |
| 11 | 功率半导体器件芯片工艺技术的研发 | 124.28 | - |
| 12 | B 档@C 档产品工艺及性能优化（IGT 改善） | 118.45 | - |
| 13 | 低压降二极管的研发 | 116.77 | - |
| 14 | 双向中压可控硅产品优化 | 114.24 | - |
| 15 | ITO-3PB 内绝缘塑封器件的开发和研究 | 111.39 | - |
| 16 | 大功率低成本特殊复合结构 TVS 的研发 | 110.72 | - |
| 17 | 快恢复二极管的研发 | 107.52 | - |
| 18 | 800V-1000V 超高压平面 VDMOS 终端结构设计 | 104.87 | - |
| 19 | 回抽顶杆技术的 TO-220FP 塑封器件开发和研究 | 103.96 | - |
| 20 | 具有两端电压不对称特性的触发管的研发 | 100.69 | - |
| 21 | D 档@E 档产品工艺及性能优化(一次镓扩散) | 100.30 | - |
| 22 | 具有失效开路特征的大功率半导体器件的研发 | 97.50 | - |

| 序号 | 项目名称 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|----|------------------------------|---------|---------|
| 23 | 低击穿电压放电管的研发 | 96.97 | - |
| 24 | 用于 G.fast 低容放电管阵列技术的研发 | 95.79 | - |
| 25 | 兼容 CMOS 工艺的氮化镓电力电子技术开发 | 95.23 | - |
| 26 | 高性能功率半导体器件技术的研发 | 83.64 | 159.37 |
| 27 | 分离栅 MOSFET 器件结构及其制造方法 | 81.77 | - |
| 28 | FRD 新技术研究 | 75.57 | 146.45 |
| 29 | 超低正向压降的 Trench 肖特基器件及制造方法 | 73.16 | - |
| 30 | 500V 高压小电流平面 VDMOS 终端结构的优化设计 | 61.72 | - |
| 31 | 大功率半导体器件 SGT 技术及产品研发 | 51.24 | - |
| 32 | 高压集成器件产品与工艺技术的研发 | 39.29 | - |
| 33 | 漏电断路器专用集成电路的研发 | 35.65 | - |
| 34 | 外延型快恢复二极管的研发 | 27.21 | - |
| 35 | 高正向阻断电压门极灵敏触发单向可控硅芯片研究开发 | 15.44 | - |
| 36 | 新型功率器件和模块的研发 | 14.68 | - |
| 37 | 带有过压斩波特性的可控硅芯片研究开发 | 11.65 | - |
| 38 | 5G 基站用片式贴装型高可靠性大功率保护器件的研究开发 | 9.31 | - |
| 39 | 新型低残压 ESD 片式元器件研发 | 2.16 | - |
| 40 | 多排框架结构的 TO-220 封装器件研发 | - | 182.21 |
| 41 | 新型氮化镓电力电子元件技术开发 | - | 165.71 |
| 42 | 内置触发放电管的塑封可控硅 | - | 156.16 |
| 43 | 埋入式两脚贴片 SOT-223/89 封装器件研发 | - | 154.51 |
| 44 | MOS 型超势垒整流器研发 | - | 152.59 |
| 45 | 新型沟槽肖特基二极管研发 | - | 137.41 |
| 46 | 低导通电阻的沟槽 MOSFET 器件研发 | - | 124.04 |
| 47 | TO-252 封装引线框架结构 | - | 114.24 |
| 48 | 双芯片横向串联型高耐压表面贴装二极管封装结构 | - | 81.68 |
| 49 | IN4148 高速开关二极管的研发 | - | 66.03 |
| 50 | 高散热能力的小型贴片固态继电器 | - | 63.88 |
| 51 | 大功率 SMBF 封装 TVS 产品的研发 | - | 63.20 |
| 52 | 一种超低漏电水平的低压 TVS 器件的研发 | - | 62.41 |
| 53 | 一种大通流斩波防雷器件 | - | 61.73 |
| 54 | 一种塑封表面贴装氧化锌压敏电阻的研发 | - | 61.02 |
| 55 | 台面外延快恢复二极管芯片的研发 | - | 60.10 |
| 56 | 一种低成本、高效率的整流桥器件的研究 | - | 56.29 |
| 57 | 共阳极整流半桥芯片及器件 | - | 53.69 |
| 58 | 双芯片垂直并联二极体封装器件 | - | 50.57 |
| 59 | 带筛孔状低应力铜引线电极的可控硅模块 | - | 49.41 |
| 60 | 用于半导体分立器件光刻的工艺技术的研发 | - | 42.96 |

| 序号 | 项目名称 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|----|--------------|-----------------|-----------------|
| 61 | 丝网漏涂玻璃钝化工艺 | - | 41.95 |
| 62 | 高结温雪崩二极管芯片组件 | - | 40.01 |
| | 合计 | 3,717.71 | 2,604.23 |

(2) 研发资金的主要用途

单位：万元

| 项目 | 2019 年度 | | 2018 年度 | |
|-------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 职工薪酬 | 1,805.60 | 48.57% | 1,474.05 | 56.60% |
| 材料费用 | 761.56 | 20.48% | 278.25 | 10.68% |
| 折旧费 | 850.98 | 22.89% | 487.52 | 18.72% |
| 委外开发费 | 254.92 | 6.86% | 249.13 | 9.57% |
| 其他 | 44.65 | 1.20% | 115.28 | 4.43% |
| 合计 | 3,717.71 | 100.00% | 2,604.23 | 100.00% |

公司研发费用主要包括支付研发人员薪酬支出、购买研发材料支出及研发设备折旧摊销，这三项费用占 2018 年度、2019 年度研发费用总额的比例分别为 86.00%、91.94%。上述三项费用 2018 年、2019 年变动分析如下：

①职工薪酬：2019 年度研发人员薪酬较 2018 年度增加 331.55 万元，增长 22.49%，主要是由于随着研发项目增加，公司也不断引进新的研发技术人员，2019 年公司研发人员数量（120 人）较 2018 年（100 人）增加 20 人，增长了 20%，研发人员薪酬增长幅度与研发人员人增长幅度基本相符；

②材料费用：2019 年度研发耗材费用支出较 2018 年增加 483.31 万元，增长 173.70%，主要是本期研发项目增加相关的材料耗用增长所致；

③折旧费：2019 年度折旧费用较 2018 年度增加 363.46 万元，增长 74.55%，主要是公司 IPO 募投项目“工程技术研究中心项目”于 2018 年 12 月 31 日达到可使用状态，导致 2019 年研发资产所计提折旧费用较 2018 年度大幅增长。

综上，公司 2019 年度研发项目的立项、研发资金的用途等与公司实际经营情况相符，研发投入的同比增长没有明显的异常。

8.年报显示，你公司其他应付款中包含股权回购义务 2,502.14 万元。请补充说明股权回购义务形成时间、形成原因、交易对方基本情况、计量方法、偿付安排及偿付进度。请会计师核查并发表意见。

公司回复：

一、公司的分析及说明

公司其他应付款中包含股权回购义务 2,502.14 万元均为公司 2017 年实施限制性股票激励计划形成。股票激励计划中对股权回购义务形成时间、形成原因、交易对方基本情况、计量方法、偿付安排及偿付进度的相关情况如下：

1、股票激励计划形成时间、形成原因、交易对方基本情况、计量方法、偿付安排

为了进一步完善公司治理结构，建立健全公司长期、有效的激励约束机制，完善公司薪酬考核体系等原因，2017 年 12 月 25 日，公司召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于<江苏捷捷微电子股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》（以下简称“股票激励计划”）的议案（公告编号：2017-064），2018 年 3 月 7 日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2017 年限制性股票激励计划授予激励对象及授予数量》的议案和《关于向公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票》的议案。（公告编号：2018-009）

根据相关议案公司同意以 2018 年 3 月 7 日为授予日，以 36.30 元/股的价格向发行公司 A 股普通股，向 90 名激励对象授予 100.14 万股限制性股票。针对向激励对象周祥瑞、殷允超授予的限制性股票，解除限售考核年度为 2019-2020 年两个会计年度，针对向其他所有激励对象授予的限制性股票，解除限售考核年度为 2018-2020 年三个会计年度每个会计年度考核一次。

2、股票激励计划的偿付进度

自 2018 年 3 月 7 日（授予日）至 2019 年 12 月 31 日，其他应付款-限制性股票回购义务余额变动情况如下：

| 期间 | 金额（万元） | 变动说明 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

| | | |
|---------|----------|-----------------------|
| 2018年3月 | 3,635.00 | 授予日授予100.14万股，每股36.3元 |
| 2018年5月 | -51.00 | 2017年度利润分配抵减 |
| 2019年3月 | -32.00 | 职工范敏波、王栋离职，股权激励终止 |
| 2019年4月 | -57.00 | 2018年度利润分配抵减 |
| 2019年5月 | -994.00 | 限制性股票第一期解禁减少 |
| 余额 | 2,502.00 | |

二、年审会计师履行的主要核查程序及核查意见

（一）主要核查程序

1、向公司管理层了解实施股权激励的原因，获取并查阅了与本次股权激励相关的文件记录；

2、获取并复核股权激励计划相关数据的计算过程、会计处理。

（二）核查意见

经核查，我们认为：捷捷微电其他应付款中包含股权回购义务均为公司2017年度对公司管理人员实行股权激励形成，股权激励计划授予价格、授予条件及解除限售条件符合相关法律、法规的要求，2019年末未解锁的限制性股票会计处理正确。

9.请在年度报告第四节“占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况”部分中补充披露营业成本、毛利率及其变动比例数据。

公司回复：

公司补充披露如下：

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|---------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 分产品 | | | | | | |
| 功率半导体芯片 | 155,387,880.86 | 98,559,568.78 | 36.57% | 39.71% | 74.62% | -12.68% |
| 功率半导体器件 | 503,531,498.61 | 266,750,604.01 | 47.02% | 20.17% | 23.13% | -1.28% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内 | 586,539,136.13 | 331,994,214.90 | 43.40% | 24.12% | 33.06% | -3.81% |

| | | | | | | |
|----|---------------|---------------|--------|--------|--------|--------|
| 国外 | 72,380,243.34 | 33,315,957.89 | 53.97% | 25.51% | 41.25% | -5.13% |
|----|---------------|---------------|--------|--------|--------|--------|

特此公告！

江苏捷捷微电子股份有限公司

董事会

2020年5月18日